

3D 白光干涉量測頭模組自動化整合

德國 3D 光學輪廓/粗度儀暨

垂直量測解析： $\leq 0.1\text{nm}$ ；量測範圍：數 nm 到 $400\mu\text{m}$ ，原廠 X/Y 軸自動疊合拼接

功能：2D/3D 表面輪廓、粗糙度、段差高度、平面度、磨耗體積等微結構表面參數量測

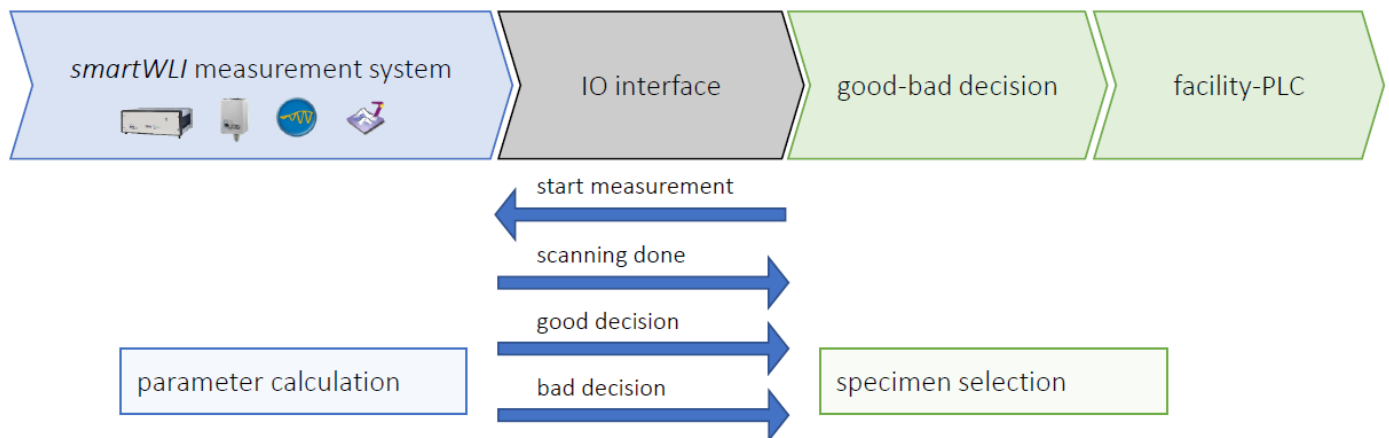
應用領域：LCD、LED、Micro lens、MEMS、半導體、晶片等微結構表面形狀參數量測



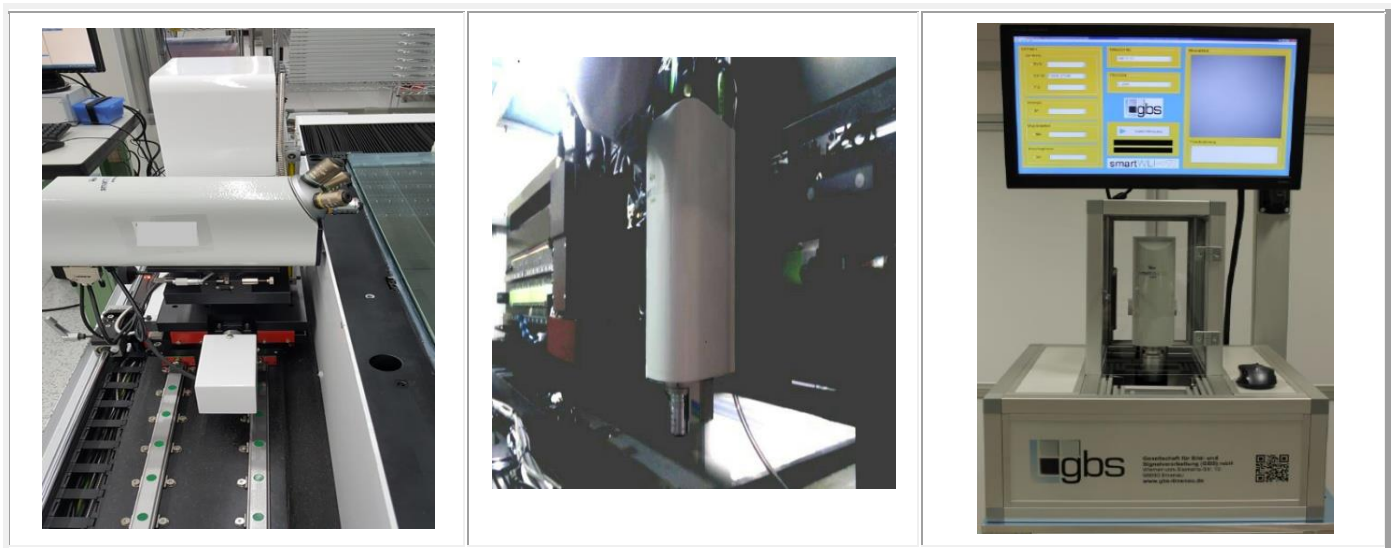
3D 白光干涉量測頭模組特點:

1. 體積小/重量輕 2-3kgs 架設方便容易
2. 精度高/掃描速度快/量測範圍大 $400\mu\text{m}$ (或選購 $5000\mu\text{m}$)
3. 相機解析度高 2.3MP(或選購 5MP 高解析度)

3D 白光干涉量測頭模組與設備快速整合流程:



1. 可搭配 AOI 光學檢測被測物之座標位置，被測物可快速移動於 3D 白光量測頭內做量測定位。
2. 通過專屬通訊模塊，將 smartWLI 3D 測量系統的控制單元與設備的 PLC 整合在一起做自動觸發量測。
3. 量測結果可輸出到預設之量測報告或 CSV 量測數據，便於後續處理及應用。



大慶科技儀器有限公司 光學掃描、逆向工程、奈米量測暨代客檢測服務

<http://www.dct3d.com> E-mail : sales@dct3d.com

701 台南市東區長榮路一段 256 號 6F-4 電話：06-236-5697 / 0933-160082 江先生